NEXTY ELECTRONICS WORLD

vol.175 APR 2019

特集企画：マキシム・ジャパン

「2019年度の展望」～マキシム・ジャパン 新社長 林孝浩氏に聞く～

製品紹介　GMSL（SerDes）サポート体制

製品紹介　脈波センサーによるヘルスケアソリューション

製品紹介　Himalaya uSLICパワーモジュール

マキシム会社概要と当社のグローバル展開

Be the Next Bridge to the Future

表紙：「春の花々」写真は社内公募の中から選ばれた作品です

CONTENTS

特集企画：マキシム・ジャパン

- インタビュー「2019年度の展望」～マキシム・ジャパン 新社長 林孝浩氏に聞く～ ―― 3・4
- 製品紹介　GMSL（SerDes）サポート体制 ―― 5
- 製品紹介　脈波センサーによるヘルスケアソリューション ―― 6
- 製品紹介　Himalaya uSLICパワーモジュール ―― 7
- マキシム会社概要と当社のグローバル展開 ―― 8

マイコン関連

- NXP Semiconductors社　Coretex-M7シリーズマイコン i.MX RTシリーズのご紹介 ―― 9・10

汎用

- Micron Technology社　Micron製 3D NAND製品ラインナップのご案内 ―― 11

モジュール・ボード

- Sierra Wireless社　M2M接続に最適でコンパクトな組込み型無線通信モジュール ―― 12

新製品

- Infineon Technologies AG社　最新！CoolMOS P7シリーズのご紹介 ～各耐圧ラインナップが揃いました～ ―― 13
- VISHAY社　ポリマータンタルチップコンデンサーT55シリーズ ―― 14
- OSRAM Opto Semiconductors社　新ラインナップ「VCSEL」と新製品シリーズ「OSIRE™」の最新情報 ―― 15

バッテリー関連

- NEC Energy Solutions社　産業用リン酸鉄リチウムイオン二次電池、ALMシリーズのご紹介 ―― 16

MATRIX ―― 17

取扱い製品一覧 ―― 18

車載ビジネスだけでなく、産業機器、ヘルスケアビジネスへも注力

「2019年度の展望」 ～マキシム・ジャパン 新社長 林孝浩氏に聞く～

株式会社ネクスティ エレクトロニクス（以下、ネクスティ）は、東アジアでMaxim Integrated Products, Inc.（以下、マキシム）と代理店契約を締結した2007年以降、着実に成長し続けるアナログ半導体を東アジア地域だけでなく、その他の地域へも広げてきました。
2018年12月に新しく就任された林社長は、4年間マキシム米国本社で製品の開発立ち上げに携わり、その経験を活かし、今も日本市場におけるマキシムファンを増やし続けています。
世界規模で半導体市場が変化する中、2019年度の展望をネクスティ 細田取締役が林社長にインタビューしました。

米国本社製品事業部在職中に幅広いリレーションを構築

細田：社長就任おめでとうございます。
まずはマキシムでの経歴を教えて頂けますか。

林：マキシムに入社したのは2003年です。2010年から2014年まで米国本社製品事業部のビジネスマネージャーとして勤務しており、BMS（バッテリーマネージメントシステム）製品と、高耐圧同期整流DC/DC Himalayaシリーズの開発立ち上げを担当しておりました。特にBMS製品に関して、オートモーティブ関係の日系OEM/Tier1様と共同開発をゼロから実施でき、非常に良い経験になりました。
製品事業部在職中に本社各部署のエグゼクティブから担当レベルまで、幅広い人脈を構築することができ、このつながりが今でも大きな財産となっております。
日本帰国後は、西日本事務所所長に着任し、オートモーティブ、産業機器、コンシューマーと弊社がターゲットとしております主要セグメント全てのお客様をサポートすることができました。

マキシム・ジャパン株式会社
代表取締役社長 **林 孝浩**

車載ビジネスの売上げが5年で約3倍に伸びる

細田：マキシム全社の業績見通しと、中長期戦略についてお聞かせください。

林：マキシム全社で特に車載ビジネスの売上の伸びが著しく、過去5年間で売上は約3倍に伸びました。弊社の会計年度2019年度の第一四半期（2018年7月-9月）におきましても15%対前年同期比で伸びております。

2019年はグローバル経済環境が不透明な状況となっておりますが、自動車の電子化の流れは止まることはなく、今後も自動車に搭載される電子部品点数は増加していくため弊社の車載ビジネスは今後も堅調に伸びていくとみています。

ADAS/自動運転分野でのNVIDIA社との協業

細田：世界市場におけるパートナーシップ戦略についてお聞かせください。

林：デジタル・アナログ分野での相互パートナーシップを構築し、お客様により良いサービスをご提供できるようにリファレンスデザインなどを揃えております。特に、自動車のADAS/自動運転分野におきましてはNVIDIA様との協業も行っています。

車載だけでなく産業機器、ヘルスケアビジネスにも注力

株式会社 ネクスティ エレクトロニクス
取締役 細田伸一

細田：日本市場におけるビジネスの状況はいかがでしょうか？

林：全社の状況とリンクしておりますが、車載ビジネスの伸びが著しく2018年度は売上の約50%を占めるようになりました。車内の高速データ転送に使用されているGMSL（ギガビットマルチメディアシリアルリンク）や機能安全規格ASILをサポートするパワーマネージメント製品が好調です。

細田：日本市場で売上げを伸ばすための中長期の取り組みや注力分野、注力製品を教えてください。

林：車載ビジネスが堅調ですが、それ以外の産業機器ビジネス、ヘルスケアビジネスにも注力しています。前者はIndustry 4.0に代表されるスマートファクトリーの流れが加速しており、IO-Link製品や小型化に向けてHimalaya uSLICパワーモジュールの採用が広がってきております。後者はバイオセンサー製品が予防医療の分野へ採用が進んできており、今後の新しい成長分野になるとみています。
世の中で起きていることは全てアナログであり、デジタル処理が高度化していく中、未来のアプリケーションをサポートするためには高性能アナログは必須の半導体であると考えております。今後も堅牢、小型化、低消費に代表される弊社の特長ある製品でお客様のお役に立てるよう開発を進めて参ります。

細田：ネクスティとしても、マキシムの強い開発力に期待をしております。お話いただいたように、車載はもちろんのこと、産業機器・ヘルスケア製品への注力も必要であり、当社ではマキシムの脈波センサーを活用したヘルスケアソリューションの開発も行っています。
また、当社はグローバル展開も得意としております。マキシム製品について、中国およびアジア全体で日系のお客様だけでなく、それ以外のお客様ともお取引しております。これは当社においてマキシムは非常に特別なサプライヤー様であることを意味しており、今後もグローバルで御社との連携を拡大し続けたいと考えております。

ODM/EMS、ソフトウェア開発、品質などのネクスティが持つ機能にも期待

細田：林社長から見たネクスティの強みや魅力は？

林：まずはオートモーティブ分野で圧倒的な経験と実績があること。更なるエレクトロニクス化が進むオートモーティブ分野への浸透力に期待しています。また、従来の商社機能だけでなく、ODM/EMSの受託、ソフトウェア開発、自社品質センターなどお客様の開発初期段階から量産までサポートできる体制を整えられている事は強みだと考えています。現在ネクスティさんとは、特にオートモーティブ分野でパートナーとしてビジネスを展開させていただいていますが、ネクスティさんの新たな取り組みと、マキシム製品がシナジーを生み、産業機器や医療機器分野など全方位でパートナーとしてWin-Winの関係を構築できることを期待しております。

細田：最後に、ぜひ林社長の抱負をお願いします。

林：ネクスティさんとのパートナーシップをさらに強化して、全てのお客様にお役に立てるような体制を構築して参ります。

細田：林社長ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

次ページ以降では、マキシムとネクスティの取り組みについて詳細をご紹介します。

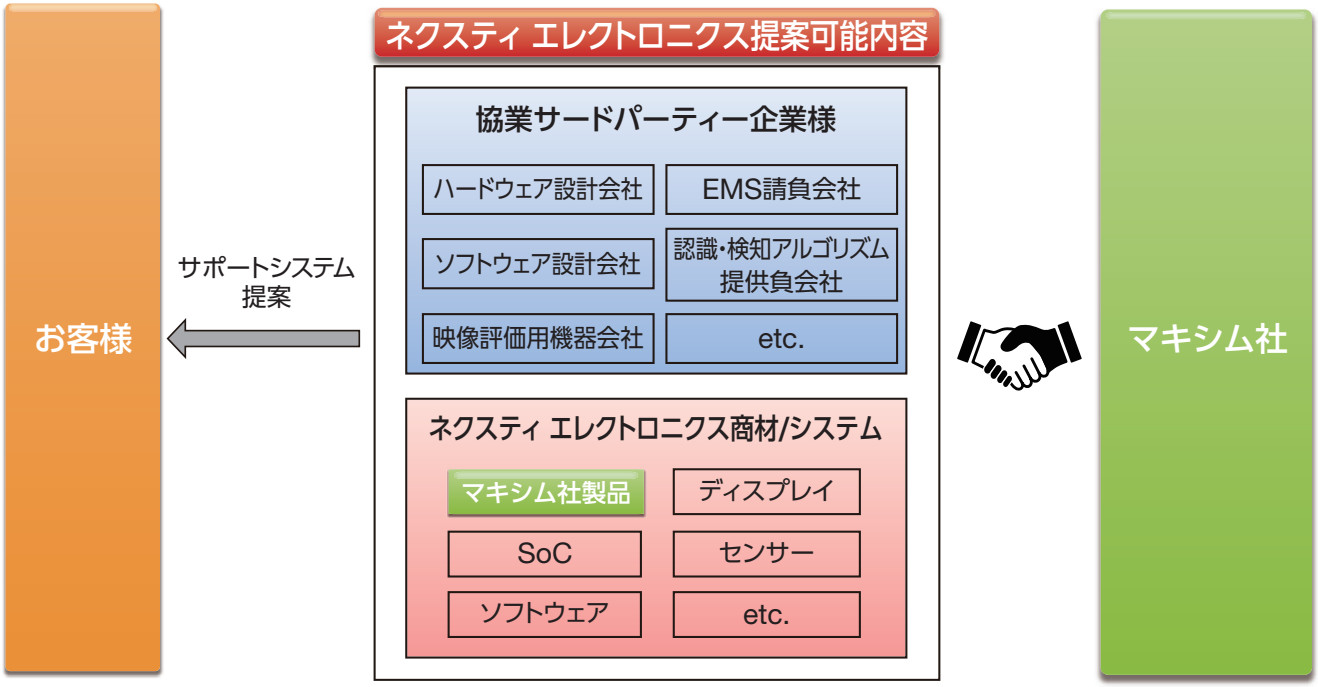
GMSL製品とネクスティのGMSLサポート体制紹介：P.5
脈波センサーを活用したヘルスケアソリューションの紹介：P.6
高耐圧同期整流DC/DC Himalayaシリーズの紹介：P.7

マキシム社

GMSL（SerDes）サポート体制

マキシム社が提供するGigabit Multimedia Serial Link（以下、GMSL）製品をご検討の際は当社へご相談下さい。開発におけるお困りごとはサードパーティーとネクスティ エレクトロニクスが連携してサポートします。
具体的には、GMSL単品での設計サポートのみならず、GMSLを使用したカメラ～SoC～表示までのハードウェア/ソフトウェア開発から信号品質/EMC評価/シミュレーション等までをサポート、提案します。

GMSL製品サポート体制図



お客様の各プロセスにおける当社サポートシステム提案について

①新しい技術/製品のご提案
お客様が開発するマキシム社製品をはじめとする当社取扱い製品を使った技術・製品の提案を実施します。

②設計技術サポート/ハードウェア・ソフトウェア設計/評価・シミュレーション
製品の設計サポートだけではなく、システム全体の開発/設計支援をサードパーティーと協業し、提供します。

③お客様のグローバル展開をサポート
世界各国に展開している当社拠点及びグループ会社拠点を活用し、グローバルでの調達をサポートします。

④EMS・ODMのご提案
量産のライン不足、海外工場での生産、少量生産等のお困りごとにおいても対応が可能です。

⑤販売サポート
当社の幅広い販路を活用し、お客様製品の販売のサポートも実施します。

お問い合わせ先／マーケティング第3部　Maximグループ　maximg_members@nexty-ele.com

マキシム社

脈波センサーによるヘルスケアソリューション

マキシム社が提供する脈波センサーと併せてネクスティ システムデザイン社（以下、NSD社）が保有するヘルスケアアルゴリズムを紹介することが可能です。
NSD社保有のアルゴリズムでは脈波の情報から血管年齢や血圧を算出することができます。
またサードパーティーを活用してコンプリートモジュールでのご提供やスマートフォンアプリの提供等ヘルスケアシステムとしてもお客様へご提案します。

マキシム社脈波センサー

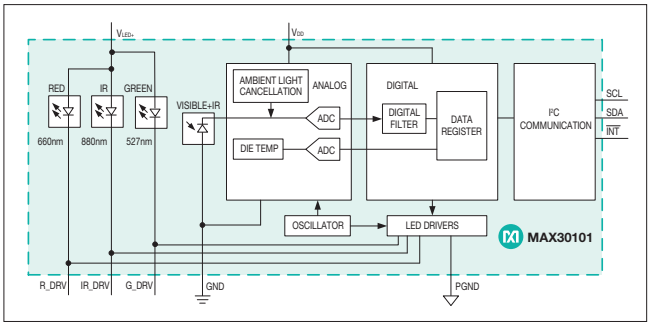
■製品特長

光電容積脈波、血中酸素濃度などを測定するためのRED/IR Green LED、Photo Diode、制御ICを小型パッケージに集積化

- 品番：MAX30101
  - ー高サンプリングレート、高SN比
  - ー小型14ピン（5.6mm×3.3mm×1.55mm）
  - ー超低シャットダウン電流:0.7μA（typ）

同製品を含むマキシム製品の情報、詳細に関しましては右記同社ホームページご覧下さい。

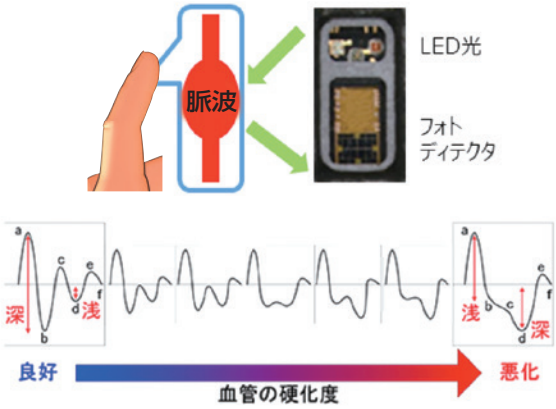
■MAX30101ブロック図



NSD社ヘルスケアアルゴリズム

■血管年齢測定アルゴリズム

「脈波」測定から血流変化を抽出し、血管の硬さの指標である血管年齢を算出。血管年齢を指標として体調確認を行うことができます。

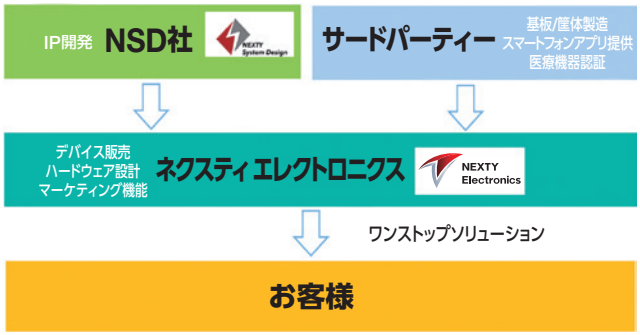


■アルゴリズムの拡張性

ハードウェアの変更無しにソフトウェアのアップデートのみで様々なバイタル情報の測定が可能です。

測定対象	開発ステータス
心拍数	着手済み
推定血圧	着手済み
血管年齢	着手済み
ストレス	着手済み
体内水分量	計画中
酸素飽和度	計画中
自律神経失調	計画中

ビジネススキーム例



■開発モジュール

■使用イメージ

■スマートフォンアプリ

お問い合わせ先／マーケティング第3部 Maximグループ maximg_members@nexty-ele.com

マキシム社

Himalaya uSLICパワーモジュール

Himalaya uSLIC™パワーモジュールは、4.0V～60Vの広い入力電圧に対応しながら、利用可能な最小のパッケージを提供します。

先進的パッケージ技術を活用して電源ソリューションサイズを小型化！

■電流ソリューションサイズを2.25倍（56%）小型化

Himalaya uSLICパワーモジュールは、先進的パッケージ技術を活用して電源ソリューションサイズを2.25倍（56%）小型化し、マイクロサイズシステムレベルIC（uSLIC）デバイスを実現しています。
これは、同期整流広入力Himalayaバックコンバーター（FET、補償、追加機能を内蔵）とインダクターを内蔵することによって達成されます。

■JESD22-B103/B104/B111の機械的規格に準拠

これらの部品を組み合わせた結果、スペースの制約が非常に厳しいシステムにおいて使用可能に。JESD22-B103/B104/B111の機械的規格に準拠した超小型パワーモジュールとなっています。さらに、CISPR 22電磁干渉(EMI)規格への準拠によって、最終製品のEMI認定の初回成功率の向上に貢献します。

Himalaya uSLICパワーモジュール ラインナップ

品　番	入力電圧	出力電圧	FB電圧精度	最大出力電流	シャットダウン電流	動作温度	PKG
MAXM17900	4V～24V	0.9V～5.5V	±1.75%	100mA	1.2uA(typ.)	−40 to +125	10pin, 2.6×3×1.5mm
MAXM17903	4.5V～24V	0.9V～3.3V	±1.44%	300mA	2.2uA(typ.)		
MAXM17552	4V～60V	0.9V～5.5V	±1.75%	100mA	1.2uA(typ.)		
MAXM15064	4.5V～60V	0.9V～5V	±1.44%	300mA	2.2uA(typ.)		
MAXM15462	4.5V～42V	0.9V～5V	±1.44%	300mA	2.2uA(typ.)		
MAXM17532	4V～42V	0.9V～5.5V	±1.75%	100mA	1.2uA(typ.)		

■製品特長

●使用が容易
- 広い入力電圧
- 高いフィードバック電圧精度
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサー

●高効率
- 固定周波数PWM
- 軽負荷効率を上げるパルス周波数変調（PFM）モード

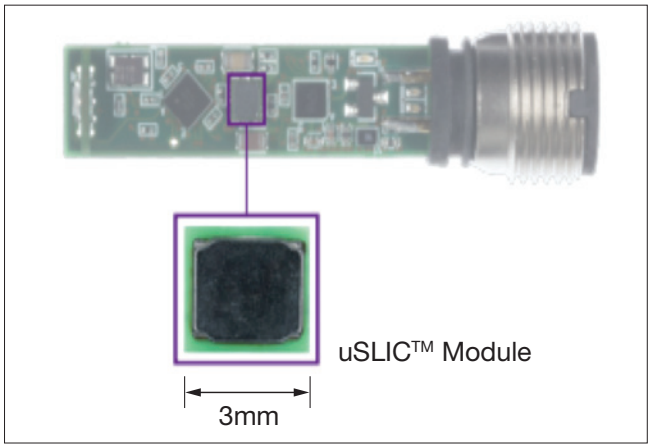
●柔軟な設計
- 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力（アクティブローRESET端子）
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド

●堅牢
- CISPR22（EN55022）Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格-JESD22-B103、B104、B111

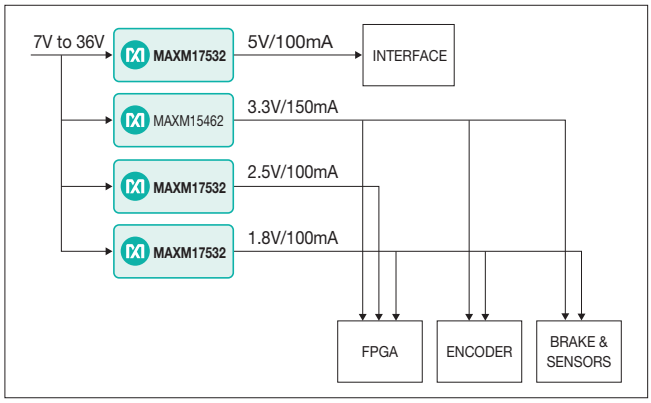
●堅牢な動作
- ヒカップ過電流保護
- 過熱保護

■アプリケーション/用途

- 4～20mA電流ループ受電センサー
- バッテリー駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
- USB Type-C給電の負荷



MAXM17532 on 超小型近接センサー



Encoder and digital rating plate向けHimalaya電源ブロック例

お問い合わせ先／マーケティング第3部　Maximグループ　maximg_members@nexty-ele.com

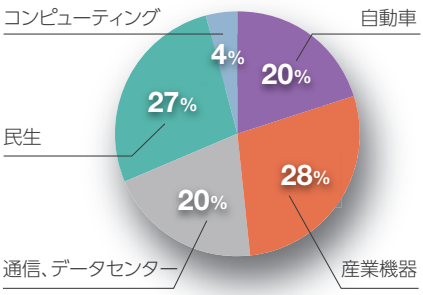
マキシム社

マキシム会社概要と当社のグローバル展開

マキシム会社概要

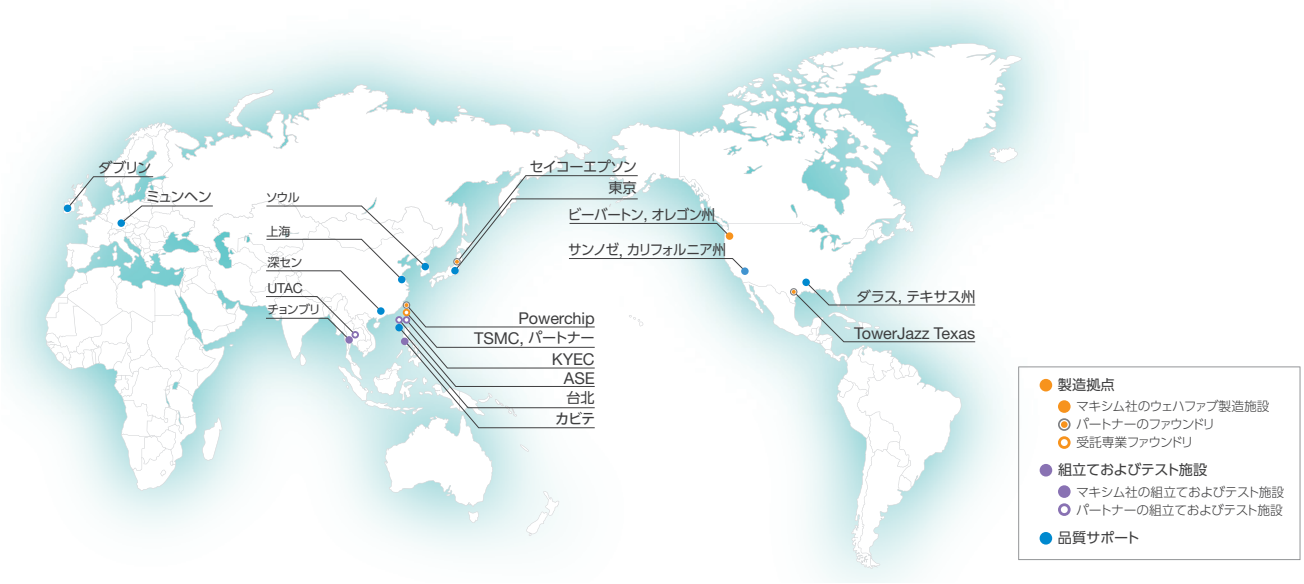
社　　名	マキシム・ジャパン株式会社
設　　立	1984年8月1日
資 本 金	4億円
代 表 者	代表取締役社長　林 孝浩
U R L	https://www.maximintegrated.com/jp.html
本社正式名称	Maxim Integrated Products, Inc.
設　　立	1983年4月1日
代 表 者	社長 兼 CEO　Tunç Doluca
売 上 高	25億ドル（2018年6月現在）
従 業 員 数	約7,000名（2018年6月現在）
本社所在地	米国カリフォルニア州サンノゼ
U R L	https://www.maximintegrated.com/en.html

●各マーケットの売上（2018年度）



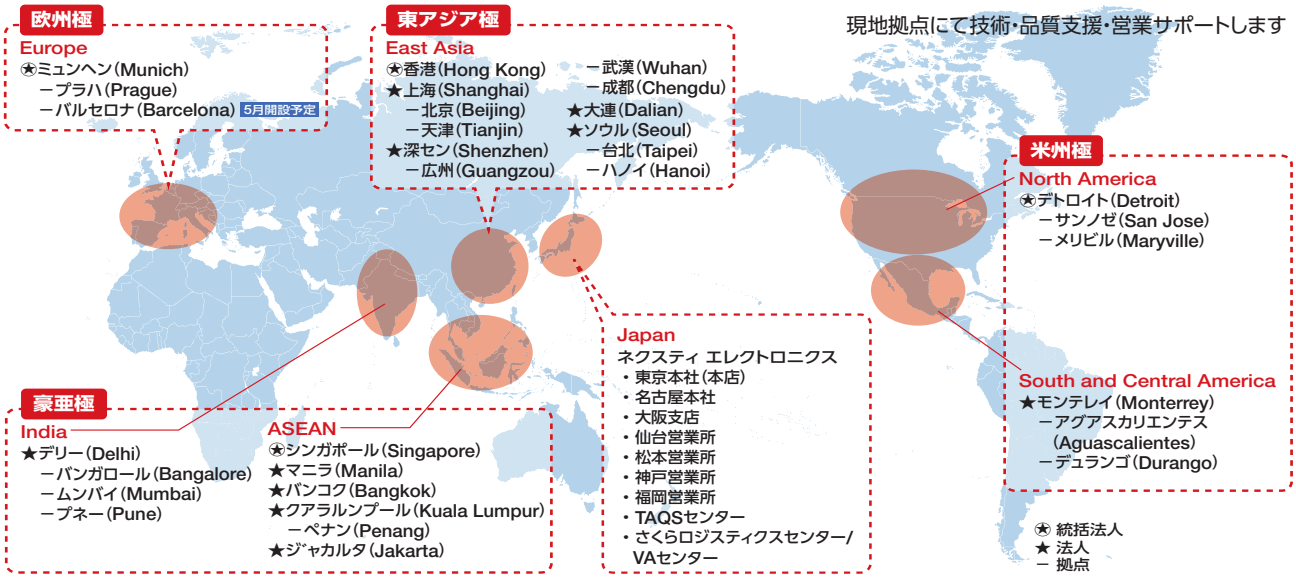
＊端数切捨てのため総数100%以下

マキシム世界拠点



当社のグローバルサポート体制について

現地拠点にて技術・品質支援・営業サポートします



お問い合わせ先／マーケティング第3部　Maximグループ　maximg_members@nexty-ele.com

NXP Semiconductors社

Coretex-M7シリーズマイコン i.MX RTシリーズのご紹介

Crossover Processor としてリリースされたNXP i.MX RTマイコン。Cortex-M3/4とCoretex-Aクラスの間に誕生した最新のプロセッサー、RTOSベースマイコンとしてDSPクラス性能の可能性を届けます。

i.MX RTシリーズの概要

- 高性能とリアルタイム処理の両立
  - –最大600MHz動作による高い処理性能(1284DMIPS)
  - –高い実行効率(2.14DMIPS/MHz)
  - –アプリケーションプロセッサー(Cortex-A)級の性能をマイコン(Cortex-M)で実現
  - –20nSecの割込みレイテンシ、最大512KBのTCM(Tightly Couple Memory)
- 低BOMコストの実現
  - –競争力のある価格
  - –PMICとDC-DCを完全に統合
  - –低価格な10×10 BGAパッケージで4層基板での設計が可能
  - –外部SDRAMインターフェイス
- 高レベルな機能を統合
  - –AES128(DPA攻撃対応、HAB)による高いセキュリティー、オン・ザ・フライQSPIフラッシュ復号
  - –2Dグラフィックスアクセラレーターエンジン
  - –パラレルカメラセンサーインターフェイス
  - –最大WVGA(800×400)解像度のLCDコントローラー
  - –マルチチャンネル高性能オーディオのための3Ch I2Sインターフェイス
- 簡単に使用可能
  - –MCU顧客は現在のツールチェーン(MCUXpresso、IAR EWARM、KEIL MDK-ARM)を使用可能
  - –NXPのFreeRTOS、SDK、ARMのmbedとグローバルなエコシステムにより、簡単で早い試作・開発が可能
  - –単一電源入力で電源の設計が容易に行える
  - –Kinetis、i.MX製品とのスケーラビリティー

i.MX RTシリーズ (1020/1050/1060) スペック一覧

Feature	i.MX RT1020	i.MX RT1050	i.MX RT1060
Core/Speed	Arm Cortex-M7 @ 500MHz	Arm Cortex-M7 @ 600MHz	Arm Cortex-M7 @ 600MHz
Cache	16 KB-I、16KB-D	32 KB-I、32KB-D	32 KB-I、32KB-D
TCM	Up to 256KB	Up to 512KB	Up to 512KB
On-chip RAM	256KB	512KB	1MB
External Memory	8/16-bit Interface for SDRAM、SRAM、NOR、NAND	8/16-bit Interface for SDRAM、SRAM、NOR、NAND	8/16-bit Interface for SDRAM、SRAM、NOR、NAND
SDIO	SD3.0/eMMC4.5×2	SD3.0/eMMC4.5×2	SD3.0/eMMC4.5×2
QSPI/HyperBus	Dual Channel/8-bit	Dual Channel/8-bit	Dual Channel/8-bit
Ethernet	10/100Mbps×1	10/100Mbps×1	10/100Mbps×2
USB with PHY	OTG、HS/FS×1	OTG、HS/FS×2	OTG、HS/FS×2
CAN	FlexCAN×2	FlexCAN×2	FlexCAN×2+CANFD×1
Graphics	–	P×P for 2D acceleration	P×P for 2D acceleration
CSI	–	8/10/16-bit Parallel	8/10/16-bit Parallel
LCD	–	8/16/18/24-bit Parallel	8/16/18/24-bit Parallel
Security	TRNG、AES-128、SHA Secure Boot	TRNG、AES-128、SHA Secure Boot	TRNG、AES-128、SHA Secure Boot
UART/SPI/I^2C	8/4/4	8/4/4	8/4/4
I^2S/SPDIF/ASRC	3/1/0	3/1/0	3/1/0
ADC	1M sample/s×2	1M sample/s×2	1M sample/s×2
ACMP/DAC	4/0	4/0	4/0
Quad ENC/Quad Timer/FlexPWM	2/2/2	4/4/4	4/4/4
GP Timer/WDOG	6/4	6/4	6/4
Package	LQFP-100、LQFP-144	BGA-196	BGA-196
Pin-to-Pin Compatible	–	Yes	Yes
Temperature	Consumer: 0˚C to 95˚C(Tj) Industrial: −40˚C to 105˚C(Tj)	Consumer: 0˚C to 95˚C(Tj) Industrial: −40˚C to 105˚C(Tj)	Consumer: 0˚C to 95˚C(Tj) Industrial: −40˚C to 105˚C(Tj)

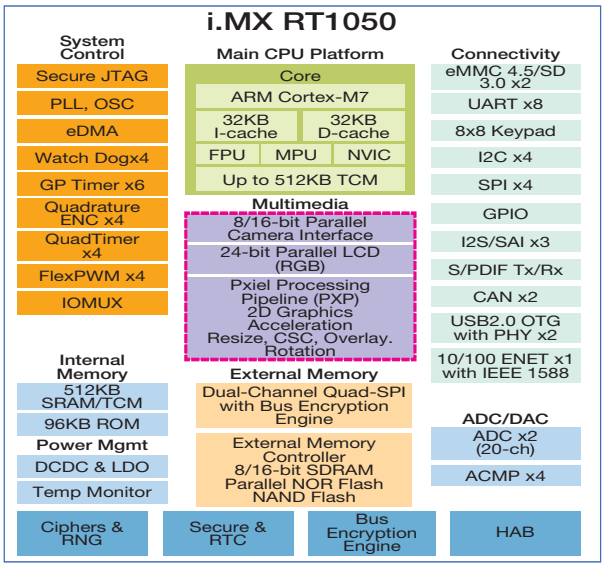
Red indicates change from column to the left

i.MX RT1050

■ 仕様
- パッケージ：MAPBGA196 | 10×10mm^2、0.65mmピッチ（130 GPIOs）
- 使用温度範囲：−40～105°C（Tj） Industrial/−40～95°C（Tj） Consumer

■ キーになる仕様とアドバンテージ
- ARM Cortex-M7プロセッサー、600MHz/500MHz
  −32KB I-Cache、32KB D-Cache
  −512KB Tightly Coupled Memory（TCM）は内蔵SRAMと共用
- 8/16-bit SDRAMコントローラー、8/16-bitパラレルNOR FLASH/PSRAM
- デュアルチャンネルクワッド-SPI NOR FLASH
- パラレルLCDディスプレイ最大WVGA（800×480）
- 8/16-bitパラレルカメラセンサーインターフェイス
- ピクセルプロセッシングパイプライン（PXP）-2Dグラフィックスアクセラレーション
- 2x eMMC 4.5/SD 3.0/SDIOポート
- 2x USB 2.0 OTG、HS/FS、デバイス/ホストPHY内蔵
- オーディオ：3x 12S/SAI、1x S/PDIF Tx/Rx
- 1x 10/100イーサネット、IEEE 1588サポート
- 2×12-bit ADC、合計最大20入力チャンネル、4xアナログコンパレーター
- 4xクオドラチャ・エンコーダ、4x Quadtimer and 4x FlexPWM
- 完全に統合されたPMU、DCDC+LDOs
- セキュリティー：TRNG、暗号化AES-128 with DPA保護、
  High Assurance Boot（HAB）, Bus Encryption Engine

■ 標準開発環境
- MCUXpresso
- FreeRTOS with SDK



MIMX RT1050評価ボード

品番：MIMX RT1050-EVKB
LCD（4.3”）：RK043FN02H-CT

プロセッサー
- MIMX RT1052DVL6A
- 600MHz ARM Corte-M7

メモリー
- 256Mbit SDRAM
- 512Mbit Hyper Flash
- QSPI Flash用フットプリント
- SDカード用TFソケット

ディスプレイ
- パラレルLCDコネクター
- カメラコネクター

オーディオ
- オーディオコーデック
- 4極-オーディオヘッドフォンジャック
- 外部スピーカー用コネクター
- マイクロフォン
- SPDIFコネクター

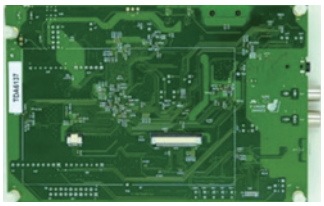
コネクティビティー
- マイクロUSBホストコネクター
- マイクロUSBOTGコネクター
- イーサネット（10/100T）コネクター
- CANトランシーバー
- Arduinoインターフェイス

デバッグ
- JTAGコネクター
- オンボードDAP-Linkデバッガ

センサー
- 6軸eコンパス（3軸磁気、3軸加速度）
  センサーFXOS8700CQ

ツール＆OSサポート
- IAR EWARM、KEIL MDK-ARM
- SDK with FreeRTOS

その他
- オールインワンボードデザイン
- 4層スルーホールプリント基板



LCD パネル

i.MX RT評価・開発環境

・無償版：コードサイズ制限なし

他、ARM Cortex・M用の商用開発環境
KEIL MDK-ARM、IAR EWARM等も
お使いいただけます。

IDE / Tool　Board / Hardware

IDE Tool　：IARシステムズARM KEIL、ARM mbed　他
OS　：Free RTOS、eForce 他
Graphic　：Crank、MICROEJ他
Board/Hardware：Embedded Artist、FDI他
各種ツール、ソフトウエアを取り扱っておりますのでお問い合わせください。

お問い合わせ先／マーケティング第4部　NXPグループ　nxp@nexty-ele.com

Micron Technology社

Micron製 3D NAND製品ラインナップのご案内

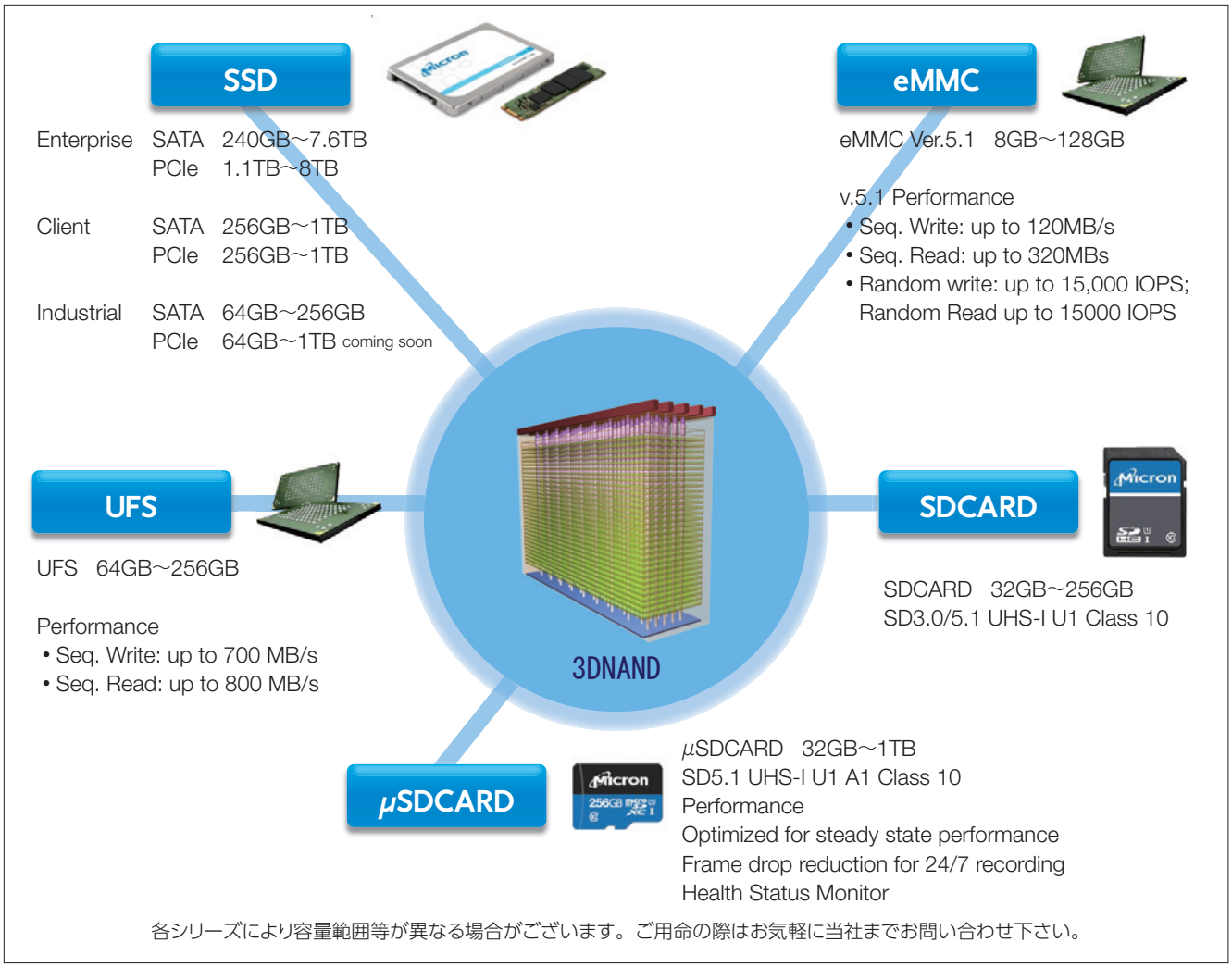
Micron社はアメリカに本社を置く、DRAM・NAND・NOR を幅広く取り扱うメモリ総合メーカーです。
今回は、その中でも3D NANDを使用したラインナップをご紹介します。

バージニア州マナサス工場生産体制の拡充

Micron社は2019年中にバージニア州マナサスにある工場の生産能力を増強。これにより最先端のDRAM・3D NANDの生産能力が拡大。長期供給対象製品の強化も行います。
特に3D ANDは注力製品となっており、SSD、eMMC、UFS。SDCARなどのストレージ製品に展開しています。
主な注力マーケットはAutomotive/Industrial/Networking/IoTなどに幅広く採用されています。
以下にてラインナップ詳細をご案内します。

バージニア州 マナサス工場 U.S.A.

3D NAND 採用製品ラインナップ



各シリーズにより容量範囲等が異なる場合がございます。ご用命の際はお気軽に当社までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先／マーケティング第2部 Micronグループ Micron-sales@nexty-ele.com

Sierra Wireless社

M2M接続に最適でコンパクトな組込み型無線通信モジュール

シエラワイヤレス社HL/WPシリーズはマシーンツーマシーン(M2M)アプリケーションに不可欠なワイヤレス接続(LTE/LPWA/5G)の要件を満たす様々な機能を提供します。
ヘルスケア、移動型POS端末、車両管理、追跡管理、スマート家電、インターネットに様々なデバイスがつながる中、組込み型無線モジュールとして待望の製品です。

コンパクト

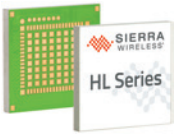
HL/WPシリーズ市場において最もコンパクトな2Gから4Gまでの1つの共通のフォームファクター(LGA 22×23mm)です。
この共通フォームファクターによって、1つのPCB設計で、音声とデータの接続を容易に統合します。HL/WPシリーズをデバイスに組込むことで、国や地域を選ばない、同様なワイヤレスなモバイルネットワークであっても、容易にグローバルな導入展開が可能になります。

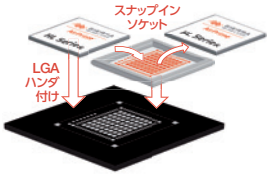
柔軟性

表面実装またはスナップイン・ソケットの柔軟なマウンティングの選択が可能。
スナップイン・ソケットによって、同一のパッド上でモジュールのみの交換が可能になります。この革新的なスナップイン・ソケットによってデバイスメーカーは、設計製造のあらゆるポイントで、また製品のライフサイクルを通してモジュールを切替えることが可能となりました。

将来の技術革新に対応

進化するテクノロジーに対応するインテリジェントなピンツーピンの互換性があります。
共通のフォームファクターのコアおよびエクステンションピンが2G、4Gモジュールで異なる構成に対応し、新旧スペックに対応するアップワード/バックワード互換性を保証します。HL/WPシリーズ全体を通じて同じピン位置は同じ機能を提供します。さらにオプションとしてカスタムピンを提供しており、テクノロジーの進化に伴う新機能が実現可能になります。





	高速LTE		中速LTE		LPWA
	EM7565	MC7430/EM7430	WP7605	HL7539	HL7800
Regional	World Wide	APAC	Japan KDDI/NTT	Japan NTT	Global
Technology	FDD/TDD LTE Cat-12 DC-HSPA+	FDD/TDD LTE Cat-6 DC-HSPA+ TD-SCDMA	LTE Cat-4 HSPA+, UMTS	LTE / Cat-4	LTE/Cat-M1/Cat-NB1
Peak Download/ Upload Rate	600/150Mbps	300/50Mbps	150/50Mbps	150/50Mbps	300/375Kbps
Form Factor Dimensions	M.2(3042) 42×30×2.3mm	Minicard/51×30×2.75 M.2(3042)/42×30×2.3	22×23×2.5mm	22×23×2.5mm	18×15×2.4mm
Temperature	−40˚C to +85˚C Class B		−40˚C to +85˚C	−40˚C to +85˚C	−40˚C to +85˚C
GNSS	Standalone, Xtra, SUPL 1.0 & 2.0, GLONASS, Galileo, BeiDou		Option	None	TBC
Approvals	Planned: FCC, IC, CE, PTCRB, GCF, NCC AT&T, Verizon, docomo, Telstra, Vodafone, Softbank, KDDI, Sprint	CE, GCF, JRF/ JPA, NCC docomo, Telstra, KDDI, Softbank	JRF/JPA, Softbank, NTT, KDDI(Planned)	JPA, JRF NTT(HL7539)	FCC, PTCRB, IC, GCF, JRF, JPA AT&T, Verizon, Telstra, Vodafone, KDDI, T-Mobile, Rogers (Planned)
Voice Capabilities	None		None		None
Host OS	Win7, Win8.1, Win10 Linux, Android		Linux Driver(Standard ECM), Android RIL		TBC
Cloud Services	Free, unlimited FOTA upgrades(AirVantage® FOTA Edition)				

お問い合わせ先／マーケティング第2部 ソリューショングループ NXT_SWI@nexty-ele.com

Infineon Technologies AG社

最新！CoolMOS P7シリーズのご紹介 ～各耐圧ラインナップが揃いました～

スーパージャンクション型MOSFETの老舗、インフィニオン テクノロジーズ社より最新シリーズCoolMOS P7のご紹介です。
CoolMOS P7は従来の使いやすさ、高性能、高効率に加え、コストパフォーマンスを併せ持った最強シリーズです。
各耐圧のラインナップが揃いましたので、あらゆるアプリケーションに提案可能、この機会にぜひご検討ください。
サンプル、お見積りのご依頼はネクスティ アドバンスド テクノロジーまで！

概要

- スーパージャンクション型MOSFET
- 最新（第7）世代プロセス
- 20年以上の実績

特長

- 耐圧600～950V幅広いラインナップ
- 産業用・民生用グレードを用意（600V）
- 面実装、スルーホール各種パッケージを用意
- 各アプリケーション全方位的に対応

アプリケーション

- 産業用電源
- LED照明
- コンシューマー製品
- ACアダプター

■600V

$R_{DS(on)}$ (mΩ) Max.	DPAK	D^2PAK	ThinPAK 8×8	TO-220 FullPAK	TO-220	TO-220 FullPAK Wide Creepage	TO-247	TO-247 4pin	SOT-223
産業用グレード									
600	IPD60R600P7			IPA60R600P7	IPP60R600P7				
360/365	IPD60R360P7	IPB60R360P7	IPL60R365P7	IPA60R360P7	IPP60R360P7				
280/285	IPD60R280P7	IPB60R280P7	IPL60R285P7	IPA60R280P7	IPP60R280P7				
180/185	IPD60R180P7	IPB60R180P7	IPL60R185P7	IPA60R180P7	IPP60R180P7		IPW60R180P7	IPZ60R180P7	
120/125		IPB60R120P7	IPL60R125P7	IPA60R120P7	IPP60R120P7		IPW60R120P7	IPZ60R120P7	
99/104		IPB60R099P7	IPL60R104P7	IPA60R099P7	IPP60R099P7		IPW60R099P7	IPZ60R099P7	
80		IPB60R080P7	IPL60R085P7	IPA60R080P7	IPP60R080P7		IPW60R080P7	IPZ60R080P7	
60/65		IPB60R060P7	IPL60R065P7	IPA60R060P7	IPP60R060P7		IPW60R060P7	IPZ60R060P7	
37							IPW60R037P7	IPZ60R037P7	
民生用グレード									
600	IPD60R600P7S			IPA60R600P7S		IPAW60R600P7S			IPN60R600P7S
360/365	IPD60R360P7S			IPA60R360P7S		IPAW60R360P7S			IPN60R360P7S
280/285	IPD60R280P7S			IPA60R280P7S		IPAW60R280P7S			
180/185	IPD60R180P7S			IPA60R180P7S		IPAW60R180P7S			

■700V

$R_{DS(on)}$ (mΩ)	TO-220 FullPAK	TO-220 FullPAK Narrow Lead	TO-252 DPAK	TO-251 IPAKショートリード	TO-251 IPAKショートリード ISOスタンドオフ付き	SOT-223	ESDクラス CDM	ESDクラス HBM
2000					IPSA70R2K0P7S	IPN70R2K0P7S	Class C3 ≧1kV	Class 1C 1-2kV
1400			IPD70R1K4P7S	IPS70R1K4P7S	IPSA70R1K4P7S	IPN70R1K4P7S		
1200					IPSA70R1K2P7S	IPN70R1K2P7S		
900	IPA70R900P7S	IPAN70R900P7S	IPD70R900P7S	IPS70R900P7S	IPSA70R900P7S	IPN70R900P7S		
750	IPA70R750P7S	IPAN70R750P7S			IPSA70R750P7S	IPN70R750P7S		
600	IPA70R600P7S	IPAN70R600P7S	IPD70R600P7S	IPS70R600P7S	IPSA70R600P7S	IPN70R600P7S		Class 2 2-4kV
450	IPA70R450P7S	IPAN70R450P7S			IPSA70R450P7S	IPN70R450P7S		
360	IPA70R360P7S	IPAN70R360P7S	IPD70R360P7S	IPS70R360P7S	IPSA70R360P7S	IPN70R360P7S		

■800V

$R_{DS(on)}$ (mΩ)	TO-220 FullPAK	TO-220 FullPAK Narrow Lead	TO-252 DPAK	TO-220	TO-247	TO-251 IPAK	TO-251 IPAK SL	SOT-223	ESDクラス HBM	ESDクラス CDM
4500			IPD80R4K5P7			IPU80R4K5P7		IPN80R4K5P7	Class 1C (1kV-2kV)	Class C3 (≧1kV)
3300			IPD80R3K3P7			IPU80R3K3P7		IPN80R3K3P7		
2400			IPD80R2K4P7			IPU80R2K4P7	IPS80R2K4P7	IPN80R2K4P7		
2000			IPD80R2K0P7			IPU80R2K0P7	IPS80R2K0P7	IPN80R2K0P7		
1400	IPA80R1K4P7		IPD80R1K4P7	IPP80R1K4P7		IPU80R1K4P7	IPS80R1K4P7	IPN80R1K4P7	Class 2 (2kV-4kV)	
1200	IPA80R1K2P7		IPD80R1K2P7	IPP80R1K2P7		IPU80R1K2P7	IPS80R1K2P7	IPN80R1K2P7		
900	IPA80R900P7		IPD80R900P7	IPP80R900P7		IPU80R900P7	IPS80R900P7	IPN80R900P7		
750	IPA80R750P7		IPD80R750P7	IPP80R750P7		IPU80R750P7	IPS80R750P7	IPN80R750P7		
600	IPA80R600P7		IPD80R600P7	IPP80R600P7		IPU80R600P7	IPS80R600P7	IPN80R600P7		
450	IPA80R450P7	IPAN80R450P7	IPD80R450P7	IPP80R450P7						
360	IPA80R360P7	IPAN80R360P7	IPD80R360P7	IPP80R360P7	IPW80R360P7					
280	IPA80R280P7	IPAN80R280P7	IPD80R280P7	IPP80R280P7	IPW80R280P7					

■950V

$R_{DS(on)}$ (mΩ)	TO-220FP	IPAK LL	DPAK	SOT-223	ESDクラス HBM	ESDクラス CDM
3700		IPU95R3K7P7		IPN95R3K7P7	1C（>1kV）	Class C3（>1kV）
2000		IPU95R2K0P7	IPD95R2K0P7	IPN95R2K0P7	2（>2kV）	
1200	IPA95R1K2P7	IPU95R1K2P7	IPD95R1K2P7	IPN95R1K2P7		
750	IPA95R750P7	IPU95R750P7	IPD95R750P7			
450	IPA95R450P7	IPU95R450P7	IPD95R450P7			

お問い合わせ先／NEXTY Advanced Technology Company（インフィニオン製品取扱いカンパニーグループ）営業1部 ICTグループ URL:http://www.nexty-ele.com/nat/

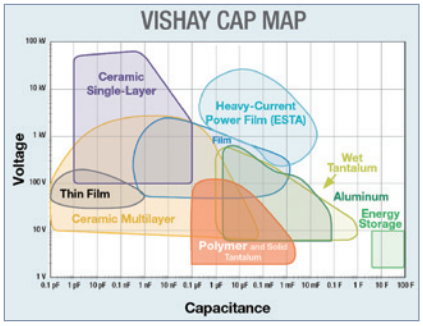
新製品

VISHAY社

ポリマータンタルチップコンデンサーT55シリーズ

半導体、電子部品の総合メーカーであるVISHAY社より今回ご紹介するのは、ポリマータンタルチップコンデンサーの新シリーズです。このたび薄型の『Zケース』(*標準Vケース比)が登場。パッケージ密度の向上により、薄型製品の設計が可能になります。

ポリマータンタルチップコンデンサーT55シリーズ



■VISHAY ポリマータンタルは、チップキャパシタとしては大容量で超低ESR

VISHAY社のポリマータンタルチップコンデンサーT55シリーズはJ、P、A、B、T(薄型B−最大1.2mm)、D、V、Zケースサイズ、2.5V〜63Vの定格電圧で3.3μF〜1000μFの幅広い容量値範囲を±20%の許容差で提供します。ポリマーカソード(陰極)により従来の二酸化マンガン品と比べて優れた性能を発揮、25℃で500mΩ〜7mΩの超低ESRを提供します。

■特長

- 導電性ポリマー電極
- −55℃〜+105℃の動作温度
- 500〜7mΩの超低ESR
- 優れた高周波数の容量保持特性

■低背の新パッケージケースリリース

新しくリリースされたZケースは、いままでの標準Vケース(EIA 7343-20)と比べて0.1mm低く、パッケージ密度の向上により薄型製品の設計を可能にします。

■アプリケーション

電力変換や配電、バッテリーデカップリングやコンピューター、サーバー、ネットワークインフラ機器、SSD無線トランシーバーにおけるバルク容量や平滑、フィルタリング回路での使用に最適です。

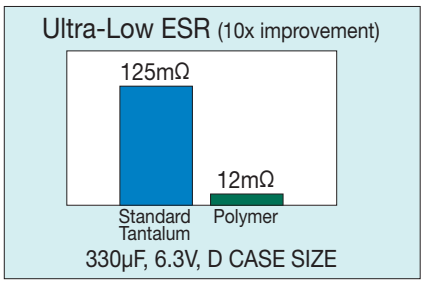
Polymer Chip Capacitors

Series		Capacitance Range	Voltage Range	ESR	Case Sizes	Operating Temperature
	T55	3.3μF〜1000μF	$2.5V_{DC}$〜$63V_{DC}$	7mΩ〜500mΩ	1608, 2012, 3216, 3528-21 3528-12, 7343-31, 7343-20 7343-19	−55℃〜+105℃
	Polymer cathode system offers low ESR and eliminates Ignition failure mode					

特長

DERATING

	Specified Derating	Example Rated Voltage	Example Design Voltage
Standard Tantalum	50%	10V	5V
Polymer	20%	6.3V	5V



Polymer Capacitors Advantages Over MLCCC	Polymer Capacitors Advantages Over Standard Tantalum	Polymer Capacitors Advantages Over Aluminum
• No piezo noise effect • No capacitance loss with DC bias • More robust design (no cracking) • Superior temperature stability	• Lower ESR • Non-barn feature • Better derating	• Superior stability • Loager life • Higher operation temperature range • Better volumetric efficiency

新製品

お問い合わせ先／マーケティング第3部 Vishayグループ vishay-pm-sales@nexty-ele.com

OSRAM Opto Semiconductors社

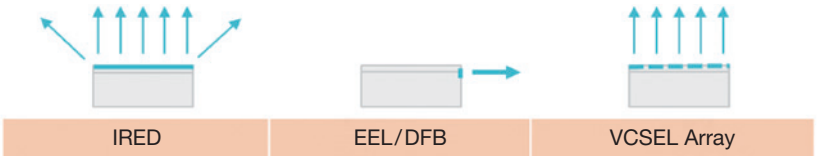
新ラインナップ「VCSEL」と新製品シリーズ「OSIRE™」の最新情報

ドイツ・レーゲンスブルグに本社を置くオスラムオプトセミコンダクターズ（以下、OSRAM社）は、※世界第2位のLEDメーカーです。製品は「より効率的に、より明るく」という方針で常日頃からアップデートが行われています。
今回は、新技術により、まったく新しいラインナップ「VCSELとOSIRE™」についてご紹介します。

※OSRAM社調べ

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting LASER)

OSRAM社は2018年にVCSELでパイオニア的存在の"Vixar社"を買収しました。
これにより、近赤外分野でIRED、車載測距用レーザーダイオードで技術リーダーであったOSRAM社に、新たな注目技術が加わりました。
VCSELは、現在モバイルデバイスの認証アプリケーションで知られていますが、今後、ジェスチャー認識や自動車アプリケーションにも展開が期待できます。
今までのレーザーダイオード（EEL/DFB）は側面からの点発光だったため、光軸のズレを抑える高い実装精度が求められてきました。VCSELは下記の通り、面発光になりますので、表面実装が可能になります。また、立ち上がりのスピードがピコオーダーであり、ジャンクション温度変化による波長変動も非常に小さいことも特長です。
右図は、直近で生産開始を予定しているVCSEL製品情報になります。



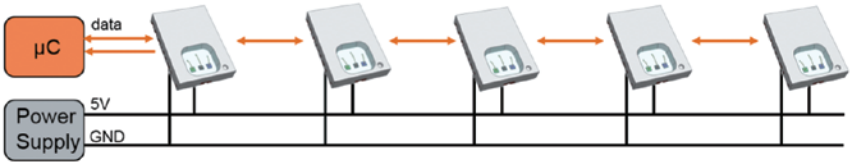
赤外 LED と既存のメタル管レーザーダイオードと VCSEL Array との発光パターンの違い

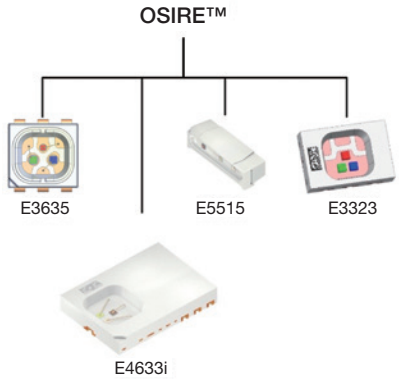
型番：PLPVQ 940A
波長：940nm
Pop Peak：600mW
Ith：60mA
QFN package：
1.95×3.20×1.20（mm）
FOV（h×V）：65°×78°
Top：0℃-60℃
Status：
Mass Production soon

型番：PLPVCQ 850/940
波長：850/940nm
Pop Peak：2W
Ith：250mA
QFN package：
2.60×3.30×0.95（mm）
FOV（h×V）：60°×45°
Top：0℃-60℃
Status：Developing

新製品シリーズOSIRE™について

OSIREは、RGBがひとつのパッケージにはいったMulti LEDで、車内のイルミネーションなどの電飾をターゲットとした製品です。
従来のMulti LEDは、ユーザーが欲しい色を再現するために、各チップへの電流値をそれぞれ試行錯誤する必要がありました。これを受けOSRAM社は、OSIREシリーズとして4点 従来のMulti LEDの廉価版、マーキング、サイドビュー、ICチップ内蔵について製品開発を発表しています。
マーキングの開発ポイントは、製品個々の特性情報をデータマトリクスコード（DMC）にて刻印が施してある事です。ユーザーはDMCを読込むことで、再現したい色、明るさに必要な電流値情報を得ることができます。OSRAM社での測定が情報のベースとなっているため、お客様のもとで測定を行う手間と、機器による誤差の削減にもつながります。
また、ICチップ内蔵の"OSIRE E4633i"では、パッケージ内にICチップを組込み、各チップへの電流値を調節する機能が実装されます。これにより、ユーザは欲しい色合い、明るさを数値で入力するだけで、色や明るさの再現が可能となります。さらに"OSIRE E4633i"同士での通信が可能となるため、マイコンへの通信路は2本のみで実装可能です。

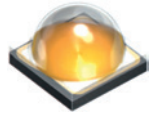




型番　：KRTBI DVLM32.31
QFN package　：4.6×3.3×0.7（mm）
Status　：Mass Production soon
PWM frequency：488Hz-122Hz
Driving scheme　：8bit per Color (256 levels)

LEDの基板実装提案

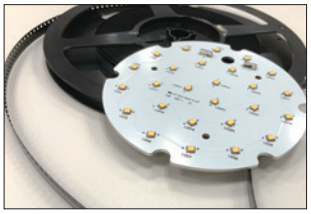
LED単品だけではなく、お客様の使用条件に最適な特性（コストメリット、スペック等）をもつ弊社取扱いの基板サプライヤーをご提案し、基板実装のサポートが可能となっています。



OSLON square

DURIS S5

＋



→ **NEXTY Electronics サポート**

お問い合わせ先／マーケティング第1部　OSRAMグループ　salesosram@nexty-ele.com

NEC Energy Solutions社

産業用リン酸鉄リチウムイオン二次電池、ALMシリーズのご紹介

NEC Energy Solutions製産業用リン酸鉄リチウムイオン二次電池、ALMシリーズは、鉛電池からの置換えを狙い設計された業界初※の製品です。鉛電池よりもはるかに優れた、業界トップクラスのサイクル寿命、充電スピードを誇り、ソーラー蓄電システムや無人搬送車(AGV)等のサイクルユース(バッテリーの放電・充電を繰り返して使用する用途)に最適です。

※NEC Energy Solutions調べ

主な特長

■鉛電池と比較し圧倒的な高性能・長寿命

- 25℃環境、1日1回フル充放電(DOD100%)の条件下で、20年以上の長寿命、鉛電池の10倍以上
- 大半の鉛電池用充電器に対応可能
- ALM12V7sHPは45A(9C)で、ALM12V35iHPは210A(6C)で連続充放電が可能
- 使用温度範囲は−40℃〜60℃と寒冷地で使用可能
- BMU(Battery Management Unit)を内蔵しており、スタンドアローンで使用可能
- AGVのモーター負荷等で、短時間に大電力を使用しても鉛電池と比較し全体容量への影響が軽微
- 同容量の鉛電池と比較し45〜65%の軽量化

■高い安全性

- 他のリチウム電池と比較し燃えにくいリン酸鉄を電極に採用
- BMU(Battery Management Unit)を内蔵し、充実した保護回路(過電圧、過電流、過放電、温度保護、ショート)
- UL1973、IEC62133、REACH、RoHS、FCC Part 15、UN38.3 認証取得

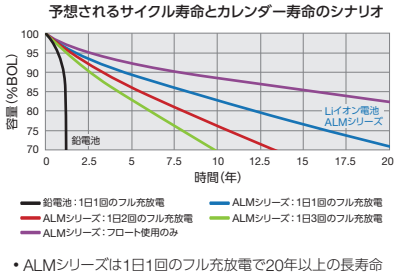
■拡張性

- 最大4直列10並列(最大40個まで)の組み合せが可能

  例：24V系の用途には、同品番のALM製品を2個直列接続で実現可能

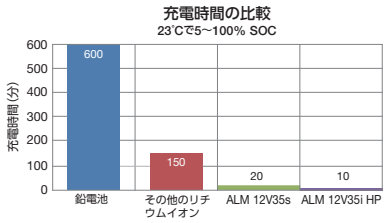
鉛電池との性能比較 (当社調べ)

■圧倒的長寿命！



- ALMシリーズは1日1回のフル充放電で20年以上の長寿命
- 同使用条件の鉛電池では2年未満で交換になる事も

■圧倒的な充電スピード



- 鉛電池より数10倍の急速充電が可能
- 充電時間が大幅削減される事により、AGV等の最終製品の運用性向上

追加基板不要で4直列10並列まで拡張可能 (同一品番で多様な電圧、容量帯を構築)

■ALM12V7 4直列10並列の組合せパターン(全40パターン)

直列数	電圧システム	容量帯 (Ah)									
		1並列	2並列	3並列	4並列	5並列	6並列	7並列	8並列	9並列	10並列
1直	12V系	5Ah	10Ah	15Ah	20Ah	25Ah	30Ah	35Ah	40Ah	45Ah	50Ah
2直	24V系	5Ah	10Ah	15Ah	20Ah	25Ah	30Ah	35Ah	40Ah	45Ah	50Ah
3直	36V系	5Ah	10Ah	15Ah	20Ah	25Ah	30Ah	35Ah	40Ah	45Ah	50Ah
4直	48V系	5Ah	10Ah	15Ah	20Ah	25Ah	30Ah	35Ah	40Ah	45Ah	50Ah

■ALM12V35 4直列10並列の組合せパターン(全40パターン)

直列数	電圧システム	容量帯 (Ah)									
		1並列	2並列	3並列	4並列	5並列	6並列	7並列	8並列	9並列	10並列
1直	12V系	35Ah	70Ah	105Ah	140Ah	175Ah	210Ah	245Ah	280Ah	315Ah	350Ah
2直	24V系	35Ah	70Ah	105Ah	140Ah	175Ah	210Ah	245Ah	280Ah	315Ah	350Ah
3直	36V系	35Ah	70Ah	105Ah	140Ah	175Ah	210Ah	245Ah	280Ah	315Ah	350Ah
4直	48V系	35Ah	70Ah	105Ah	140Ah	175Ah	210Ah	245Ah	280Ah	315Ah	350Ah

ラインナップと仕様

ALM12V7 外観

ALM12V35 外観

品　番	ALM 12V7s	ALM 12V7sHP	ALM 12V35s	ALM 12V35iHP (CAN Bus)	ALM 12V35iHP (SM Bus)
公称電圧	13.2V		13.2V		
公称容量(Ah)	5Ah		35Ah		
推奨フロート電圧	13.6V〜14.4V		13.6V〜14.4V		
並列可能数(追加基板不要)	最大4直列10並列(48V系50Ahまで)		最大4直列10並列(48V系350Ahまで)		
サイズ(mm)	151×64.5×99.7		197×132×179.5		
サイクル寿命(23℃)	14,000回以上 (DOD：100%、+1C/-1C)				
動作温度	−40〜60℃		−40〜60℃		
最大充電/放電電流(連続)	23A(4C)	45A(9C)	105A(3C)	210A(6C)	
通信機能	無		無	有(CANOpen)	有(SMBus)
重量(おおよそ)	0.92Kg	0.93Kg	6.3Kg	6.3Kg	

■アプリケーション

- 無人搬送車(AGV)
- UPS
- バッテリー式溶接機
- 蓄電システム
- 業務用クリーナー
- ソーラー街路灯
- 電動草刈り機
- 高所作業車
- サイネージ
- ポータブル測定機器
- ゴルフカート

※株式会社ネクスティ エレクトロニクスはNEC Energy Solutionsの日本国内唯一の正規代理店です

お問い合わせ先／マーケティング第2部　ソリューショングループ　ALMバッテリーお問い合わせ窓口　nec-es@nexty-ele.com

MATRIX

カテゴリー / メーカー名称	半導体										電子部品							ボード類、機器、その他				
	マイコン/FPGA/プロセッサー	ディスクリート	センサー	オプト製品	電源IC	アナログIC	デジタルIC	メモリー	通信IC	MEMS	受動部品	接続部品	ストレージ関連	表示/HMI関連	センサー類	電池類	プリント基板	通信モジュール	パワーモジュール	ボード類	機器	その他
Analog Devices Inc.	●		●	●	●	●	●		●	●												
ASMediaTechnology Inc.									●													
Elite Semiconductor								●														
Infineon Technologies AG	●	●	●		●	●	●		●	●												
Maxim Integrated	●		●		●	●	●		●													
Micron Technology Inc.								●					●									
NEXPERIA		●					●															
NVIDIA Corporation	●						●													●	●	●
NXP Semiconductors	●	●	●		●	●	●		●													
OSRAM Opto Semicondustors GmbH			●	●																		
Qualcomm									●													
STMicroelectronics N.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
TDK MICRONAS GmbH	●		●																			
Texas Instruments Incorporated	●		●		●	●	●		●	●												
Techpoint, Inc.						●			●													
VISHAY Intertechnology, Inc.		●	●	●	●	●					●											
Xilinx, Inc.	●																					
ソニーセミコンダクターソリューションズ株式会社			●						●													
愛知製鋼株式会社			●																			
AU Optronics Corporation														●								
Career Technology (Mfg.) Co.,Ltd.												●					●					
Dynamic Electronics												●					●					
Kinwong Electronic		●			●	●	●		●								●					
NEC Energy Solutions, Inc.																●						
Payton Planar Magnetics Ltd.											●											
LEM Holding SA															●							
Rayben Technologies															●		●					
RECOM Power GmbH																			●			
Seagate Technology													●									
Sierra Wireless Inc.																		●				
Toyo Aluminium K.K.			●														●					
TTM (Viasystems)																	●					
u-blox AG			●			●	●		●									●				
Unimicron																	●					
Yes Optoelectronics Co.Ltd.														●								
新電元工業株式会社		●			●	●																
新日本無線株式会社						●	●		●													
積水ポリマテック株式会社																						●
日本シイエムケイ株式会社																	●					

目次ページへ
ネクスティ エレクトロニクス ホームページへ

取扱い製品一覧

半　導　体

Analog Devices Inc.
高性能アナログ半導体(ADC、DAC、AMP、電源 etc)、オーディオ/ビデオIC、DSP、各種センサー、他

ASMedia Technology Inc.
デジタル高速インターフェイスSATA、PCI Express、USB3.0/3.1コントローラー、Hub、マルチプレクサ製品

Elite Semiconductor Memory Technology Inc.
低容量DRAM(SDRAM/DDR1/DDR2/モバイルSDRAM/モバイルDDR)、NAND型フラッシュメモリー及びNANDベースのMCP、SDRAM、DDR1、DDR2のKGD製品

Infineon Technologies AG　P13
車載用半導体(レギュレーター、DC/DC、ハイサイドSW、ローサイドSW、FET、プリッジ、GMR、ホールセンサー、Driver IC、CAN、LIN)、32bitマイクロコントローラー(ARM)、パワーデバイス(高耐圧パワーMOSFET、低電圧パワーMOSFET、電源制御用IC、IGBT、IBGTモジュール)、IPM、高周波ディスクリート(移動体通信用)、NFC、TPM、Chip Card &セキュリティー製品、大気圧センサー

Maxim Integrated　P3～8
セキュアマイコン、認証IC、生体センサー、ジェスチャーセンサー、ガスセンサー、1-wire、SerDes、I/O LINK、大電流電源IC、データコンバーター、オペアンプ、インターフェイス、RF IC、バッテリー管理IC、チューナーIC、リファレンス、光トランシーバー、パワーマネージメント、センサー、スイッチ・マルチプレクサー、クロック及び発振機、高耐圧電源IC

Micron Technology Inc.　P11
DRAM、LPDRAM、DRAM Module、NOR Flash、NAND Flash、eMMC、MCP(NVM+RAM)、PCM、SD Cards、SSD

NEXPERIA B.V
ロジックIC、MOS-FET、小信号トランジスター、ダイオード

NVIDIA Corporation
GPU、SoC(自動運転プラットフォーム、組み込みプラットフォーム、ディープラーニング学習コンピューター、各種ソフトウェア)

NXP Semiconductors　P9･10
【オートモーティブ】マイクロコントローラ/プロセッサ、セーフティ・ボディ・パワートレイン向けASSP、カー・オーディオ用DSP、カー・チューナー専用IC、車載ネットワーク用IC(FlexRay、CAN、LIN、SBC)、各種センサー、キーレスエントリ/イモビライザー/MOSFET、RF、パワーマネジメントIC
【マルチマーケット】ARMマイコン、NFC、各種I²Cバス用IC、電源コントローラーIC、RFディスクリート、RTC、LEDドライバー・コントローラー

OSRAM Opto Semiconductors GmbH　P15
面実装LED、赤外受発光素子、半導体レーザー

Qualcomm
Bluetooth、WiFi、GNSS、等通信系半導体

STMicroelectronics N.V.
車載向けIC
8bit(自社)/32bit(PowerPC、ARM)マイコン、ボディ・パワートレーン・セーフティ向け各種ASSP、GNSS、オーディオパワーアンプ、チューナーIC、MOSFET、IGBT、ダイオード、LEDドライバー、レギュレーター、EEPROM、セキュアメモリー、モーションMEMSセンサー、高精度オペアンプ/コンパレーター/電流センスアンプなど、ミリ波レーダー用MMIC、CMOSイメージセンサー
非車載向けIC
8bit(自社)/32bit(ARM)マイコン、セキュアマイコン、メモリ(EEPROM)、モーションMEMS、環境センサー、ToF測距センサー、MEMSマイク、アンプ&コンパレータ、RF(BluetoothLE、NFC、Sub GHz帯、PLLシンセ他)、モータドライバー、LEDドライバー、MOSFET、IGBT、ダイオード、トライアック、サイリスタ、電源用IC(AC/DC、DC/DC、チャージャ等)、USB PD、I/Oリンク、保護素子、シリコンフォトニクス、プロセスファウンダリィ

Techpoint, Inc.
映像伝送インターフェイスIC(HD-TVI)、LCDコントローラー、アナログビデオコーダー

TDK MICRONAS GmbH
リニアホールセンサー、ホールスイッチ、360度角度センサー、3相BLDCドライバー内蔵12V直結8-bitマイコン、デジタル出力の電流トランデューサー

Texas Instruments Incorporated
アンプ、オーディオ、クロック/タイミング、データ・コンバータ、DLP®製品、インターフェイス、アイソレーション、ロジック、モータ・ドライバー、電源IC、組込みプロセッサー、RF Blue ToothLE、SubGH帯、ミリ波、センサー製品、スイッチ/マルチプレクサ、ワイヤレス・コネクティビティ

VISHAY Intertechnology, Inc.　P14
シリコニクス(パワーMOSFET、アナログスイッチ、パワーIC、スマートロードスイッチ)、ダイオード製品(パワーダイオード、整流素子、サージ吸収素子、プリッジダイオード)、オプトエレクトロニクス製品(赤外線受発光素子、IrDA製品、近接・照度センサー)受動部品(インダクター、精密抵抗、巻線抵抗、面実装型パワー抵抗、MELF抵抗、大容量コンデンサ、フィルムコンデンサー、ハイブリッドコンデンサー、タンタルコンデンサー)

Xilinx, Inc.
FPGA、Logic製品(Spartan6、Artix7)、ARM Coreを内蔵したMPSOC(Zynq Ultra Scale+)

ソニーセミコンダクターソリューションズ株式会社
CMOSイメージセンサー、インターフェイス(Gigabit Video Interface)

愛知製鋼株式会社
地磁気センサー(MIセンサー)

電子部品　ボード類・機器・その他

AU Optronics Corporation
液晶ディスプレイパネル(産機、車載、アミューズ、サイネージ向け等)、タッチパネル

Career Technology(Mfg.)Co., Ltd.
FPC、リジッドフレキ

Dynamic Electronics
両面～8層貫通基板、Semi Flex基板、Rijid Elex基板、厚銅多層基板、HDI基板、高周波対応積層基板

Kinwong Electronic
金属基板(AL、銅)、銅インレイ、両面～8層多層基板、厚銅多層基板

NEC Energy Solutions, Inc.　P16
産業用リン酸鉄リチウムイオン二次電池
12V 5Ah仕様：ALM12V7s、ALM12V7sHP
12V 35Ah仕様：ALM12V35s、ALM12V35i HP CAN bus、ALM12V35i HP SMBus

Payton Planar Magnetics Ltd.
カスタム平面型トランス、カスタム平面型インダクター、カスタムトランス+インダクター一体型製品

LEM Holding SA
高性能電流センサー、電圧センサー

Rayben Technologies
セラミックインレイ基板、金属基板(アルミ、銅)、両面～8層多層基板

RECOM Power GmbH
DC/DCコンバーター、AC/DCコンバーター、スイッチングレギュレーター、LEDドライバー

Seagate Technology
ハードディスクドライブ(HDD)、PCIe SSD、SAS SSD、ストレージシステム

Sierra Wireless, Inc.　P12
広域無線通信(LTE/UMTS/HSDPA、Edge/GPRS、EV-DO/CDMA)モジュール、M2Mソリューション

Toyo Aluminium K.K
AL　RFID/AL+PET　FPC/AL+PI FPC/CU+PI FPC/電磁波シールド/導電性接着剤/導電性ペースト/ALペースト伸縮配線板/AL箔インサート成形品

TTM(Viasystems)
4層～10層貫通基板、厚銅多層基板

u-blox AG
GNSSセンチメーター級高精度測位(SSR-RTK/2周波)、マルチGNSS(GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応)レシーバーIC及びモジュール製品、推測航法ソリューション(3Dセンサー内蔵モジュール等)、OSR-RTKモジュール、eCall/ERA-GLONASS対応ワイヤレス通信モジュール(GSM/GPRS、UMTS/HSPA+、LTE Cat. NB1/M1/1/4/6/9/16/19、5G)、近距離無線モジュール(Bluetooth classics/Bluetooth low energy/Bluetooth 5、WLAN.11a/b/g/n/ac/ax、V2X向け.11p)

Unimicron
両面～8層貫通基板、Semi Flex基板、Rijid Elex基板、銅インレイ基板、厚銅多層基板、HDI基板、高周波対応積層基板

Yes Optoelectronics Co. Ltd
カスタムLCDパネル(LCDタイプ：TN、HTN、STN、FSTN、DSTN、DFSTN、ESTN、ASTN、VA、FS)、モノクロTFTパネル、カラーTFTパネル、バックライトLEDモジュールなど

新電元工業株式会社
ダイオード、FET、バリスタ、電源モジュール、サイリスタ、IGBT

新日本無線
各種半導体(オペアンプ/コンパレーター・電源IC・オーディオ/ビデオIC・他

積水ポリマテック株式会社
静電容量タッチスイッチセンサーシート、放熱シート、樹脂成型、ラバー成型

日本シイエムケイ株式会社
プリント配線板

ネクスティ エレクトロニクス企画製品

自社開発製品
新たなサイネージシステム　スマートコムサイネージ®
クラウド型配信システム連動、屋外/屋内対応

目次ページへ

ネクスティ エレクトロニクス
ホームページへ

次の、未来へ。

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

東京本社（本店） 〒108-8510 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
TEL:03-5462-9611 FAX:03-5462-9690

名古屋本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル
TEL:052-558-4100 FAX:052-561-1761

大阪支店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル
TEL:06-6243-6611 FAX:06-6243-6701

仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー
TEL:022-221-8061 FAX:022-221-8055

松本営業所 〒390-0815 長野県松本市深志2-5-26 松本第一ビル
TEL:0263-34-6131 FAX:0263-34-6130

神戸営業所 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル
TEL:078-272-1660 FAX:078-272-1770

福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 紙与博多ビル
TEL:092-436-4001 FAX:092-436-4002

商品センター 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0001 FAX:042-846-0101

VAセンター 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0088 FAX:042-846-0099

TAQSセンター 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町大縄1-3 豊通物流ビル
TEL:0566-96-4433 FAX:0566-97-3467